

2009年3月期決算に関する補足資料

1. 決算概要

億円未満は切捨て表示しています

(連結)

	2008年3月期 第4四半期 2008.1-2008.3		2009年3月期 第4四半期 2009.1-2009.3		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
売上高	2,298	-	1,057	-	△ 54.0 %
売上総利益	735	32.0 %	192	18.2 %	△ 73.8 %
営業利益	349	15.2 %	△ 95	△ 9.0 %	-
経常利益	371	16.2 %	△ 82	△ 7.8 %	-
税前利益	310	13.5 %	△ 105	△ 10.0 %	-
当期純利益	182	7.9 %	△ 21	△ 2.0 %	-

単位:億円

	2008年3月期 通期 2007.4-2008.3		2009年3月期 通期 2008.4-2009.3		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
	9,060	-	5,080	-	△ 43.9 %
	3,112	34.4 %	1,374	27.0 %	△ 55.9 %
	1,684	18.6 %	147	2.9 %	△ 91.3 %
	1,727	19.1 %	205	4.0 %	△ 88.1 %
	1,692	18.7 %	96	1.9 %	△ 94.3 %
	1,062	11.7 %	75	1.5 %	△ 92.9 %

2. 部門別・地域別 売上高

(連結)

	2008年3月期 第4四半期 2008.1-2008.3		2009年3月期 第4四半期 2009.1-2009.3		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
半導体製造装置					
国内	450		180		△ 59.9 %
米国	339		169		△ 50.1 %
欧州	183		97		△ 46.5 %
韓国	165		52		△ 68.4 %
台湾	593		55		△ 90.7 %
中国	51		7		△ 85.2 %
東南アジア他	80		25		△ 68.1 %
海外計	1,413		407		△ 71.2 %
計	1,864		588		△ 68.4 %
FPD/PV製造装置					
国内	8		107		-
欧州	-		0		-
韓国	47		107		123.7 %
台湾	76		55		△ 27.7 %
中国・東南アジア	10		5		△ 45.5 %
海外計	135		168		24.6 %
計	143		275		91.8 %
電子部品・情報通信機器					
国内	264		179		△ 32.4 %
海外	24		13		△ 45.4 %
計	289		192		△ 33.5 %
その他					
国内	1		1		△ 14.7 %
海外	-		-		-
計	1		1		△ 14.7 %
合計					
国内	725		468		△ 35.5 %
海外	1,573		589		△ 62.5 %
計	2,298		1,057		△ 54.0 %

単位:億円

	2008年3月期 通期 2007.4-2008.3		2009年3月期 通期 2008.4-2009.3		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
	1,919		1,053		△ 45.1 %
	1,087		653		△ 39.9 %
	369		303		△ 17.7 %
	732		375		△ 48.7 %
	2,549		493		△ 80.7 %
	298		110		△ 62.9 %
	308		263		△ 14.5 %
	5,345		2,200		△ 58.8 %
	7,264		3,253		△ 55.2 %
	307		186		△ 39.4 %
	-		0		-
	177		349		97.3 %
	151		284		88.3 %
	44		60		36.4 %
	372		694		86.3 %
	680		881		29.5 %
	1,008		845		△ 16.2 %
	103		96		△ 6.5 %
	1,111		942		△ 15.3 %
	4		3		△ 15.5 %
	-		-		-
	4		3		△ 15.5 %
	3,239		2,088		△ 35.5 %
	5,821		2,992		△ 48.6 %
	9,060		5,080		△ 43.9 %

3. 事業の種類別 売上高及び営業利益

(連結)

	2008年3月期 第4四半期 2008.1-2008.3		2009年3月期 第4四半期 2009.1-2009.3		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
産業用電子機器					
売上高	2,012		867		△ 56.9 %
営業費用	1,671		967		△ 42.1 %
営業利益	340		△ 100		-
電子部品・情報通信機器					
売上高	291		193		△ 33.6 %
営業費用	282		188		△ 33.0 %
営業利益	8		4		△ 52.4 %
消去又は全社					
売上高	△ 4		△ 2		-
営業費用	△ 4		△ 2		-
営業利益	0		0		3.1 %
連結					
売上高	2,298		1,057		△ 54.0 %
営業費用	1,948		1,153		△ 40.8 %
営業利益	349		△ 95		-

単位:億円

	2008年3月期 通期 2007.4-2008.3		2009年3月期 通期 2008.4-2009.3		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
	7,960		4,148		△ 47.9 %
	6,312		4,019		△ 36.3 %
	1,648		128		△ 92.2 %
	1,121		947		△ 15.5 %
	1,084		928		△ 14.4 %
	36		18		△ 49.7 %
	△ 20		△ 14		-
	△ 20		△ 14		-
	0		0		△ 14.6 %
	9,060		5,080		△ 43.9 %
	7,375		4,933		△ 33.1 %
	1,684		147		△ 91.3 %

4. 受注高

PAGE 2/2

(連結)

単位:億円

	2008年3月期 第4四半期 2008.1-2008.3		2009年3月期 第4四半期 2009.1-2009.3		増減率	2008年3月期 通期 2007.4-2008.3		2009年3月期 通期 2008.4-2009.3		増減率
半導体製造装置	983		204		△ 79.2 %	5,041		2,145		△ 57.4 %
FPD/PV製造装置	610		64		△ 89.4 %	1,299		605		△ 53.4 %
電子部品・情報通信機器	259		179		△ 30.6 %	1,103		904		△ 18.0 %
その他	1		1		△ 14.7 %	4		3		△ 15.5 %
合 計	1,854		450		△ 75.7 %	7,447		3,659		△ 50.9 %

5. 受注残高

(連結)

単位:億円

	2008年3月期 第4四半期 2008.3末		2009年3月期 第4四半期 2009.3末		増減率
半導体製造装置	1,846		737		△ 60.0 %
FPD/PV製造装置	1,271		995		△ 21.7 %
電子部品・情報通信機器	132		94		△ 28.3 %
合 計	3,249		1,828		△ 43.7 %

6. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結)

単位:億円

	2008年3月期 第4四半期 2008.1-2008.3		2009年3月期 第4四半期 2009.1-2009.3		増減率	2008年3月期 通期 2007.4-2008.3		2009年3月期 通期 2008.4-2009.3		増減率
設備投資額	57		48		△ 15.9 %	227		181		△ 20.2 %
減価償却実施額	60		63		5.9 %	214		230		7.7 %
研究開発費	182		150		△ 17.3 %	660		609		△ 7.7 %

7. 期末人員

(連結)

	2008年3月期末	2009年3月期末
国内	7,789	7,865
米国	1,281	1,226
欧州	450	376
アジア	909	924
合 計	10,429	10,391

- * 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。
- * 利益率及び増減率については、1円単位の金額をもとに計算しています。

2010年3月期業績予想に関する補足資料

1. 2010年3月期業績予想概要

億円未満は切捨て表示しています

(連結)

単位:億円

	2009年3月期(通期)実績		2010年3月期予想					
	第2四半期 累計期間	通期	第2四半期 累計期間	利益率	増減率	通期	利益率	増減率
売上高	3,012	5,080	1,260	-	△ 58.2 %	3,000	-	△ 41.0 %
営業利益	262	147	△ 420	△ 33.3 %	-	△ 630	△ 21.0 %	-
経常利益	289	205	△ 410	△ 32.5 %	-	△ 610	△ 20.3 %	-
税前利益	286	96	△ 410	△ 32.5 %	-	△ 610	△ 20.3 %	-
当期純利益	173	75	△ 260	△ 20.6 %	-	△ 380	△ 12.7 %	-
単位:円								
一株当り配当金	20	24	4			8		

2. 部門別 売上高

(連結)

単位:億円

	2009年3月期(通期)実績		2010年3月期予想					
	第2四半期 累計期間	通期	第2四半期 累計期間	構成比	増減率	通期	構成比	増減率
半導体製造装置	2,087	3,253	600	47.6 %	△ 71.3 %	1,640	54.6 %	△ 49.6 %
FPD/PV製造装置	401	881	295	23.4 %	△ 26.6 %	590	19.7 %	△ 33.0 %
電子部品・情報通信機器	521	942	365	29.0 %	△ 30.0 %	770	25.7 %	△ 18.3 %
その他	2	3	-	0.0 %	-	-	0.0 %	-
合計	3,012	5,080	1,260	100.0 %	△ 58.2 %	3,000	100.0 %	△ 41.0 %

3. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結)

単位:億円

	2009年3月期 (通期)実績	2010年3月期 (通期)計画
設備投資額	181	100
減価償却実施額	230	200
研究開発費	609	540

- * 2010年3月期 予想作成時の使用レート: US\$1=¥95
- * 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。
- * 利益率、増減率及び構成比については、1円単位の金額をもとに計算しています。